

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2026-016

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,317,536,658 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鹏鼎控股	股票代码	002938
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周红	马丽梅	
办公地址	深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 30 层	深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 30 层	
传真	0755-33818102	0755-33818102	
电话	0755-29081675	0755-29081675	
电子信箱	a-h-m@avaryholding.com	a-h-m@avaryholding.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、产品及其用途介绍

公司是主要从事各类印制电路板的研发、设计、制造、销售与服务为一体的专业大型厂商，专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，根据下游不同终端产品对于 PCB 的定制化要求，为客户提供涵盖 PCB 产品研发、设计、制造与销售服务各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司的 PCB 产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板、汽车\服务器及其他用板等，产品广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器、汽车电子等下游领域。

通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通讯电子产业的多类终端产品上，并以智能手机领域为主，满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时性的持续要求。公司生产的通讯用板包括柔性印制电路板、刚性印制电路板、高密度连接板、类载板（SLP）等多类产品，服务的客户包括了国内外领先电子品牌客户。

消费电子及计算机用板主要应用于平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游消费电子及计算机类产品。

汽车\服务器用板及其他用板主要应用于传统及电动汽车、服务器、光模块等行业。公司近年来加快了对汽车及 AI 服务器、光模块等 AI 数据中心市场的开拓，相关产品已经和正在陆续获得国内外客户认证。

报告期内公司主要业务及产品未发生重大变化。

（二）公司产品地位与竞争优势

公司为全球范围内少数同时具备各类 PCB 产品研发、设计、制造、销售与服务的专业大型厂商，拥有优质多样的 PCB 产品线，主要产品范围涵盖 FPC、SMA、SLP、HDI、RPCB、Rigid Flex 等多类产品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车和 AI 服务器、光模块、高速计算机等产品，具备为不同客户提供全方位 PCB 电子互联产品及服务的强大实力，打造了全方位的 PCB 产品一站式服务平台。

公司具备雄厚的技术研发实力、及时的订单响应能力、完善的品质保障能力，为客户提供优质领先的产品及服务，切实满足客户需求。得益于公司多样化的产品策略，以及卓越的及时响应、批量供货能力，下游国内外领先品牌客户均与公司保持长期的业务合作。

根据中国电子电路协会（CPCA）中国电子电路排行榜，公司连续多年位列中国第一。同时根据 Prismark 2018 至 2026 年以营收计算的全球 PCB 企业排名，公司 2017 年-2025 年连续九年位列全球最大 PCB 生产企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	48,849,582,772.20	44,542,561,839.93	9.67%	42,278,162,758.58
归属于上市公司股东的净资产	34,136,963,183.17	32,109,843,557.76	6.31%	29,650,687,131.66
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	39,147,009,392.27	35,140,384,498.03	11.40%	32,066,047,781.90
归属于上市公司股东	3,737,843,458.40	3,620,351,391.33	3.25%	3,286,953,204.23

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,534,359,318.87	3,531,375,434.56	0.08%	3,170,101,901.38
经营活动产生的现金流量净额	7,285,787,285.05	7,082,423,666.52	2.87%	7,968,561,814.22
基本每股收益（元/股）	1.61	1.56	3.21%	1.42
稀释每股收益（元/股）	1.61	1.56	3.21%	1.42
加权平均净资产收益率	11.42%	11.73%	-0.31%	11.38%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	8,086,837,206.27	8,288,454,418.38	10,480,141,560.64	12,291,576,206.98
归属于上市公司股东的净利润	488,156,707.96	744,867,178.00	1,174,536,884.52	1,330,282,687.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,912,388.81	670,596,275.06	1,096,212,880.48	1,289,637,774.52
经营活动产生的现金流量净额	2,504,703,146.61	1,772,230,360.23	-18,379,282.26	3,027,233,060.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,425	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
美港实业有限公司	境外法人	66.19%	1,534,242,198.00	0.00	不适用	0	
集辉国际有限公司	境外法人	5.71%	132,402,775.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.71%	62,734,091.00	0.00	不适用	0	

全国社保基金一零三组合	其他	1.73%	39,999,981.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	11,491,235.00	0.00	不适用	0
悦泮有限公司	境外法人	0.45%	10,318,217.00	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.35%	8,200,627.00	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	6,252,400.00	0.00	不适用	0
全国社保基金四一六组合	其他	0.27%	6,228,600.00	0.00	不适用	0
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	5,388,988.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中:1、美港实业有限公司及集辉国际有限公司均为臻鼎科技控股股份有限公司(TW:4958)间接控制的全资子公司;2、美港实业有限公司持有悦泮公司11.82%的股权;3、经查询公开资料,全国社保基金一零三组合、全国社保基金四一六组合均为全国社保基金投资组合。除以上股东关联关系外,未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

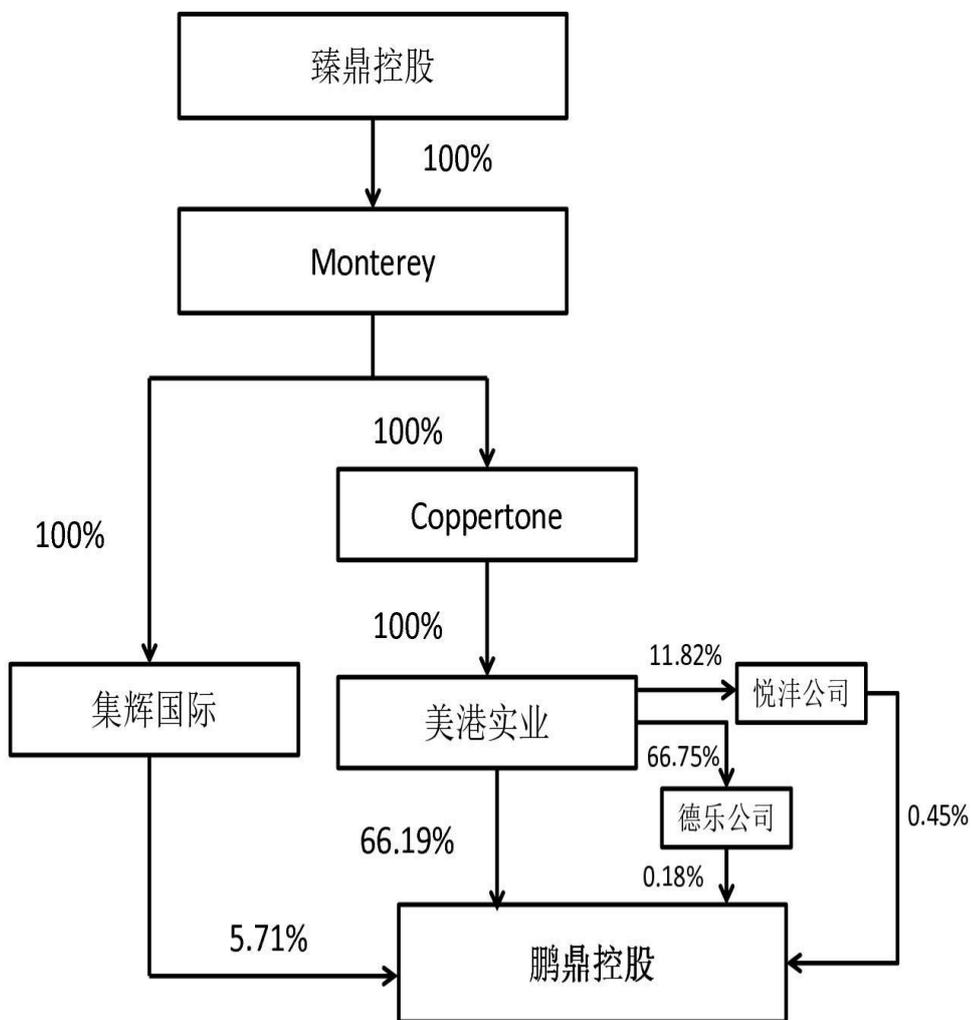
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

2025 年，人工智能技术迅猛发展驱动算力需求爆发，以 AI 服务器为代表的下游市场快速扩张，全球印刷电路板（PCB）行业迎来了快速发展。面对全球贸易环境变化及供应链紧张等外部不确定性，公司保持战略定力，精准把握产业趋势，通过巩固存量客户份额、拓展新兴业务领域，实现营业收入稳步增长。

同时，原材料价格持续上涨叠加汇率波动加剧，对成本控制及利润成长形成压力；公司为抢抓 AI 服务器市场机遇，持续加大资本开支，短期内折旧费用的增加对盈利成长也带来了一定的压力。面对上述挑战，公司积极维护供应链稳定，深入推进降本增效，把握市场趋势，积极开拓新客户、新产品，保持了稳健的盈利水平。

2025 年公司实现营业收入 391.47 亿元，同比增长 11.40%；实现归属于上市公司股东净利润 37.38 亿元，同比增长 3.25%。

1、把握市场发展机遇，各产品线业务快速发展

2025 年，公司的各项业务均实现了稳步且显著的增长：

通讯用板业务方面，依托于在 FPC 产品上的技术优势和产能优势，公司持续提升产品的市场份额，并积极参与客户新产品、新技术的开发，继续维持行业的领先地位。报告期内，公司通讯用板业务实现营业收入 254.37 亿元，同比增长 4.95%，通讯用板业务毛利率为 19.03%，较上年同期增长 0.86 个百分点。

消费电子及计算机用板业务方面，公司把握消费电子复苏周期，并积极推动 AI 眼镜为代表的 AI 端侧产品的开发与量产，实现了相关业务的快速成长，报告期内，公司消费电子与计算机用板业务实现营业收入 112.87 亿元，同比增长 15.72%，消费电子与计算机用板业务毛利率为 27.15%，较上年同期增长 0.13 个百分点。

汽车\服务器用板业务方面，受 AI 服务器市场需求激增的影响，公司相关业务继续保持高速增长。公司积极推动市场知名客户新一代产品认证与打样，同时，进一步扩大与云服务器厂商在 AI ASIC 相关产品的开发与合作，以增强公司产品在 AI 服务器市场的竞争力，目前相关产品已经和正在通过认证中。报告期内，公司汽车\服务器用板业务实现营业收入 21.19 亿元，同比增长 106.67%，汽车\服务器用板业务毛利率为 21.55%。

2、全面覆盖 AI 时代云管端应用，积极布局前瞻技术

AI 技术已成为推动 PCB 行业发展的核心驱动力。为把握新一轮产业发展机遇，公司依托“One Avary”PCB 全产品品类平台，持续加大 AI 类产品的研发创新与战略布局，全面覆盖 AI 时代“云-管-端”应用场景。2025 年，公司研发投入达 24.59 亿元人民币，占营业收入比重为 6.28%，较上年同期研发投入金额增长 5.79%。

在智能终端设备方面，公司凭借动态弯折 FPC 模块、高频宽天线模组、超细线路 FPC 组件技术、N+M 叠构天线开发，成为折叠手机、AI 手机、XR 模组等终端装置的核心供货商；2025 年，公司 AI 眼镜类业务实现营业收入较 2024 年增长 4 倍以上，已成为全球最大 AI 眼镜 PCB 制造商。面对人形机器人所带来的巨大市场空间及其对 PCB 要求技术难度高的背景，公司积极开发用于主控系统、传感器模块、电源管理、关节驱动等核心功能的 PCB 产品，并与多家国内及国际机器人客户建立合作关系，持续进行产品开发与打样，以高精度、高密度布线产品满足客户高阶 PCB 需求。

在 AI 服务器领域，公司依托淮安园区与泰国园区两大生产基地，以 IHDI 及 HLC 为核心产品线，聚焦客户下一代产品需求，积极开拓市场。公司加速推进 AI 服务器相关技术的研发，推出支持 GPU 模块与高速传输接口的高阶 HDI、内埋元件内埋线路、低损耗材料开发、背钻残段技术，满足 AI 服务器高算力需求，并积极与客户就未来 2-3 代平台产品展开前期

技术研讨与联合开发。2025 年，公司 AI 服务器类产品实现营业收入较 2024 年增长超 1 倍，预计 2026 年将继续保持强劲增长态势。

在光通讯方面，公司凭借自身在高阶 mSAP 工艺上领先的技术优势与量产优势，瞄准 800G/1.6T 光通讯升级窗口，并与客户合作开发下一代 3.2T 光通讯解决方案。随着 1.6T 光模块的放量，未来相关业务预计将继续快速成长。

在车用 PCB 产品领域，公司还研发了耐高温、抗振动的 HDI 产品，以应对车用 PCB 的特定要求。

在人工智能技术的推动下，AI 深度应用与数字化转型已成为公司不断布局前瞻性产品的驱动力，公司持续为不同客户提供全方位 PCB 产品解决方案，以先进的制程技术及优异的质量深耕客户，在 AI 智慧终端、AR/VR 空间计算终端、车载智慧座舱、车载自动驾驶模块、AI 服务器及边缘计算、低空经济载体、具身智能机器人、脑机接口模组等新蓝海 PCB 产业，不断拓展前瞻性技术的研究与布局，以确保在相关领域的技术前沿保持优势地位。

3、加快全球产能布局，推进数字化转型升级，为新一轮扩张打下基础

2025 年，公司进一步加速全球产能布局进程：在国内，公司计划于 2025 年下半年至 2028 年间投入人民币 80 亿元，在淮安园区扩充高阶 PCB 产能。预计至 2026 年底，淮安园区的 IHDI 与 HLC 产能将实现翻倍增长，显著提升公司在 AI 服务器类产品领域的供给能力，同时，公司于 2026 年初与淮安经济技术开发区签署投资协议，拟于未来投资 110 亿元建设高端 PCB 项目生产基地。

在海外，公司泰国一厂已于 2025 年 5 月进入试产阶段，主要生产高阶 IHDI、HLC 及光通讯模块产品。目前量产爬坡进展顺利，并已通过多家客户认证；尚有数家服务器与光通讯领域的全球领先客户正在进行积极认证。随着产能利用率的提升，公司将不断优化产品组合，进而提升产品毛利率。同时，公司泰国二厂、三厂、五厂及机械钻孔中心四座厂房正在同步建设。未来，这些新增产能将有效满足客户对高阶 AI 产品日益增长的需求，进一步巩固公司在全球高端电子制造领域的竞争优势。

公司高度重视通过智能制造与数字化转型持续提升生产效率与管理效能。在新厂建设初期，便前瞻性地规划并构建了 AI 与生产系统的深度融合与联动机制，实现数据驱动业务，打造“检测-预测-决策”全闭环的智慧工厂体系。针对现有工厂的升级改造，公司通过深入现场调研、精准解析痛点、科学评估效益，制定并实施系统化的升级对策方案，构建了覆盖全流程的智慧工厂成熟度管理体系。在集团层面，公司全面推动数字化转型升级工作，充分运用人工智能技术赋能生产管理与经营决策，持续优化运营流程，确保单位人均产值稳步提升，从而进一步增强整体盈利能力和市场竞争力。

4、维护供应链安全与稳定，重视财务稳健与经营安全

2025 年，是 PCB 行业扩张的重要一年，各大 PCB 厂商均加大了资本开支以扩充产能，随之带来了上游设备的紧缺。公司凭借“善待供应商”的理念，与各供应商建立了友好的长期合作关系，依托良好的商业信誉以及雄厚的资本实力，获得了供应链的有力支持，保证了各项扩产计划的顺利实施。同时，面对上游原材料价格的波动，公司供应链管理部门充分发挥自身作用，一方面，通过专业团队实时分析国际政治经济形势对铜、金等国际大宗商品的影响，以及上游材料供应商的供应情况等，为公司原材料采购提供决策依据，另一方面，通过供应链的数字化转型升级，提升决策效率，更加迅速地应对市场变化，并与多家上游关键供应商建立策略联盟，保证了公司供应链的稳定。2025 年，公司营业收入较上年增加 11.40%，营业成本较上年增加 10.37%，毛利率较上年提升 0.74 个百分点，在整体上游原材料涨价的背景下，仍实现了较好的成本控制与盈利能力。

公司非常重视财务稳健与经营安全，确保各项财务指标保持在健康水平，并维持充足的现金流。截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金为 120.32 亿元，资产负债率为 28.86%，公司应收账款（含应收票据）周转天数为 56 天，存货周转天数 43

天，均为行业较好水平。充足的货币资金储备、稳健的资产负债结构以及高效的资产周转能力，体现了公司在财务管理和业务运营上的卓越执行力度，为公司的长期稳健发展和资本扩张提供了稳定支持，实现公司稳健经营与成长。